



Elke Eckstein

Elke Eckstein ist als Vice President Fab 30 für die Fertigung und Technologieentwicklung in AMDs Dresdner Werk zur Fertigung von Mikroprozessoren auf 200 mm-Wafern verantwortlich. Sie wird darüber hinaus die grundlegende Neugestaltung der Fab 30 zur 300 mm-Fabrik Fab 38 steuern.

Seit 2003 war Elke Eckstein Chief Executive Officer von ALTIS Semiconductor, einem Joint Venture für Advanced Logic Semiconductors von IBM und Infineon. Zuvor verantwortete sie als Chief Operating Officer das operative Geschäft für das bei Paris ansässige Unternehmen.

Von 1998 bis 2001 arbeitete Elke Eckstein in mehreren Führungspositionen der Bereiche Technologieentwicklung und Product Engineering bei ProMOS, einem früheren Joint Venture für Memory Produkte von Infineon und Mosel Vitelic mit Sitz in Taiwan.

Elke Eckstein begann ihre Laufbahn im Halbleiterbereich von Siemens, der später unter dem Namen Infineon Technologies ausgegründet wurde.

Von 1990 bis 1993 arbeitete sie in mehreren Engineering-Positionen der Entwicklungsallianz von Siemens und IBM für Speicherprodukte in East Fishkill, USA. An diesen Aufenthalt schlossen sich von 1993 bis 1996 weitere Aufgaben in der Siemens-IBM-Fertigungsallianz in Corbeil-Essonnes, Frankreich, an. Von 1996 bis 1998 war Elke Eckstein für den Bereich Forschung und Entwicklung von Speichern im Dresdner Simec-Werk verantwortlich.

Elke Eckstein absolvierte die Schule für Mikroelektronik in München.



Elke Eckstein

Elke Eckstein is Vice President of Fab 30 with the responsibility for all wafer fab operations and technology of Fab 30, AMD's 200 mm fab in Dresden. In addition, she will oversee the transformation of Fab 30 to 300 mm wafer production as Fab 38.

Since 2003, Elke Eckstein assumed role of CEO of Altis Semiconductor, a joint venture for Advanced Logic Semiconductors between IBM and Infineon in the Paris, France area where she had previously run the operations as the Chief Operating Officer.

From 1998 to 2001, Elke Eckstein held a number of executive roles in technology development and product engineering at ProMOS, a former joint venture for Memory Products between Infineon and Mosel Vitelic in Taiwan.

Elke Eckstein started her career with Siemens Semiconductor, which later became Infineon. From 1990 to 1993, she filled in a variety of engineering positions, first in East Fishkill, NY where Siemens and IBM had established a memory development alliance. From 1993 to 1996, an assignment to the Siemens-IBM manufacturing alliance in Corbeil-Essonnes, France, followed. From 1996 to 1998, she was responsible for Memory research and development of Siemens' Dresden-based manufacturing facility named Simec.

Elke Eckstein holds a degree from the Munich, Germany-based School of Microelectronics.